

2021年度の事業活動の総括と2022年度の展望

事業活動を通じた持続的な成長を実現

2021年度(2021年1月~12月)の事業活動の総括 過去最高の収益を更新

2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響下にあったものの、国や地域にばらつきを伴いつつも、先進諸国を中心に経済や社会活動に回復基調の動きがみられました。各国で加速する在宅勤務・学習の導入、デジタルトランスフォーメーション(DX)への投資や新生活様式への対応を背景に、データ量増加や5Gへの切り替え等、IoT投資が進展。加えて、脱炭素社会実現に向けた取組みが始まっています。

当社グループの関係市場である電子基板・部品業界は、IoTやAI、5G等の技術の広がりにより高密度化や技術革新が進み、特に、当社と関連深い半導体を搭載するパッケージ(PKG)基板において需要の拡大が継続しました。これら関連市場は引き続き高い成長が見込まれ、移動通信システムは、5Gへの切り替えや普及に向けた

取組みがさらに活発化。また、次世代データセンター用高性能PKG基板向けの生産体制強化に向けた積極的な設備投資が進展しています。

このようななか、当社グループは高密度電子基板向け製品の開発、販売に注力。主要製品の売上動向は次のとおりです。PKG基板向けに高いシェアをもつ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」については、強い半導体需要で大きく増加しました。微細配線の形成を可能にする「EXEシリーズ」は高いディスプレイ需要により、また、多層電子基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は自動車市場復調の影響を受け、堅調に推移しました。一方、ディスプレイ向け「SFシリーズ」は、関連電子機器需要の落ち着きによる影響等で減少しました。

2022年度の展望

過去最高収益の更新
+
密着向上剤「CZシリーズ」のさらなる需要拡大

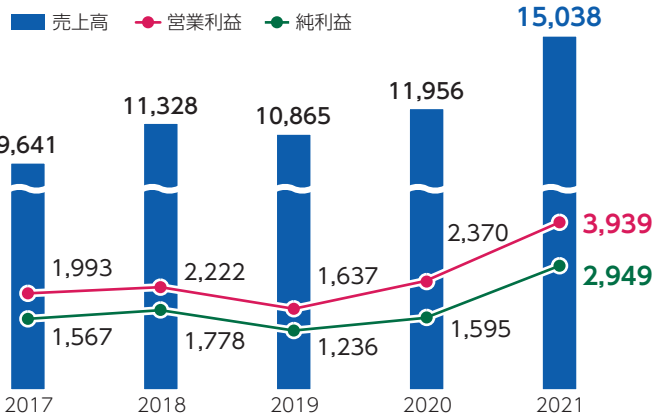
2022年度連結業績予想

売上高 **166.5億円** (当期比10.7%増) | 営業利益 **42億円** (当期比6.6%増)

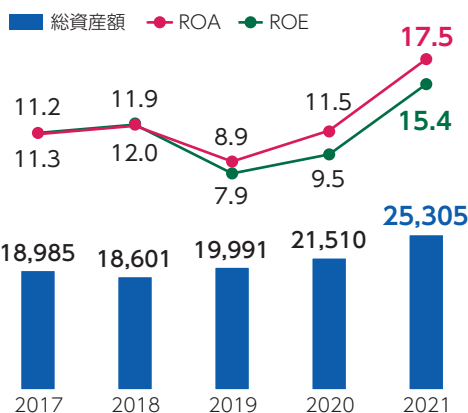
今後の半導体市場は、IoTやAI、5G等の社会全体のデジタル化、DXの実現や脱炭素社会に向けた動向を背景に、データ量増加や通信の高速化が促進され、右肩上がり成長していくと見込まれます。これにより半導体を搭載するPKG基板のさらなる需要や高性能化による面積拡大を背景に、「CZシリーズ」をはじめ関連する製品の需要の伸びが想定されることから、当社製品の安定供給に向け、日本国内における新生産拠点への設備投資の検討を始めております。これは「2030年ビジョン Phase1」中期経営計画の重点取組みの一つ「安定した調達、生産、供給体制確立」の一環でもあり、調達先多様化やグローバル供給網の拡充と合わせて戦略的に進めてまいります。(2022年7月現在)

連結財務データ

売上高/営業利益/純利益(百万円)



総資産額(百万円)/ROA(%) / ROE(%)



地域セグメント別売上高比率(%) / 売上高(百万円)

